



Final Product/Process Change Notification

Document #:FPCN23597XA

Issue Date:07 Sep 2021

Title of Change:	Conversion of select onsemi, Czech Republic (Roznov) wafer fab technologies from 150mm to 200mm wafer diameter - MC33074 and LM124A families.
Proposed First Ship date:	14 Dec 2021 or earlier if approved by customer
Contact Information:	Contact your local onsemi Sales Office or Ken.Wong@onsemi.com
PCN Samples Contact:	Contact your local onsemi Sales Office or PCN.samples@onsemi.com . Sample requests are to be submitted no later than 30 days from the date of first notification, Initial PCN or Final PCN, for this change. Samples delivery timing will be subject to request date, sample quantity and special customer packing/label requirements.
Additional Reliability Data:	Contact your local onsemi Sales Office or Tomas.Vajter@onsemi.com
Type of Notification:	This is a Final Product/Process Change Notification (FPCN) sent to customers. FPCNs are issued 90 days prior to implementation of the change. onsemi will consider this change accepted, unless an inquiry is made in writing within 30 days of delivery of this notice. To do so, contact PCN.Support@onsemi.com
Marking of Parts/ Traceability of Change:	Manufacturing traceability will be controlled by product date code.
Change Category:	Wafer Fab Change
Change Sub-Category(s):	Manufacturing Process Change

Sites Affected:	
onsemi Sites	External Foundry/Subcon Sites
onsemi Wafer Substrate Manufacturing Roznov, Czech Republic	None

<p>Description and Purpose:</p> <p>The purpose of this FPCN is to announce the conversion of smaller wafer size to larger wafer size at the onsemi, Czech Republic (Roznov) wafer fab to increase fab productivity.</p> <p>A full electrical characterization over the temperature range has been performed on each product to ensure the device functionality remain unchanged and electrical performance within specification.</p> <p>Qualification tests are also performed on the transferred devices to ensure the reliability of these devices remain unchanged.</p> <p>Before Change Increase wafer fab productivity by converting smaller wafer size to larger wafer size. Wafer size: 150mm Location: onsemi, Czech Republic (Roznov) wafer fab</p> <p>After Change Increase wafer fab productivity by converting smaller wafer size to larger wafer size. Wafer size: 200mm Location: onsemi, Czech Republic (Roznov) wafer fab</p>
--



Final Product/Process Change Notification

Document #:FPCN23597XA

Issue Date:07 Sep 2021

Reliability Data Summary:

QV device name: NCV33074

RMS# 69241

Package: SOIC14

Test	Specification	Condition	Interval	Results
HTOL	JA108	Ta= 125°C, Test @ R, H, C	2016 hrs	0/240
PC	JA112	SMD only, Test @ 0 & EP		0/231
	JA113			
SAT		Test pre- and post- PC		pass
ELFR	JA018	TA = 125°C for 48 hrs; Test @ R, H	48hrs	0/2400
TC	JA104	Test @ R, H	1000cyc	0/270
BS	AEC-Q100-001	30 bonds from 5units; after TC500/1000cyc		pass
BPS	M883	3gm Pull Force Min; after TC500/1000cyc		pass
	Method 2011			
ESD HBM	AEC-Q100-002	c = 0, Test @ R, H	2kV	0/3
ESD CDM	AEC-Q100-011	c = 0, Test @ R, H	1kV	0/3
ED	ON Data Sheet	Cpk > 1.67	Cpk>1.67	Pass (3 wafer lots)
		Test @ R, H, C		
LU	AEC-Q100-004	Test @ EP; Test & Stress @ R, H	LU->100mA	0/6
			LU->100mA	

Electrical Characteristics Summary:

Electrical characteristics are not impacted. All Data Sheet specifications remain the same.

List of Affected Parts:

Note: Only the standard (off the shelf) part numbers are listed in the parts list. Any custom parts affected by this PCN are shown in the customer specific PCN addendum in the PCN email notification, or on the [PCN Customized Portal](#).

Part Number	Qualification Vehicle
SC2902DTBR2G	MC33074ADR2G
LM324ADTBR2G	MC33074ADR2G
LM324ADR2G	MC33074ADR2G
MC34074DR2G	MC33074ADR2G
MC34074ADR2G	MC33074ADR2G
MC33074DTBR2G	MC33074ADR2G
MC33074ADTBR2G	MC33074ADR2G
MC33074ADR2G	MC33074ADR2G

Japanese translation of the notification starts here.
通知の日本語訳はここから始まります。

Note: The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。

変更件名:	オンセミ、チェコ共和国 (ロジュノフ) のウエハ製造技術においてウエハ径の選択を 150mm から 200mm に変換 - MC33074 および LM124A ファミリー	
初回出荷予定日:	2021 年 12 月 14 日またはお客様からの承認が得られた場合はそれ以前.	
連絡先情報:	現地のオンセミ営業所または < Ken.Wong@onsemi.com > にお問い合わせください。	
サンプル:	現地のオンセミ営業所または < PCN.Samples@onsemi.com > にお問い合わせください。 サンプルは、この変更の初回 PCN または最終 PCN の最初の通知の日付から 30 日以内に要求してください。 サンプル納入時は、依頼日、数量、特別梱包材/ラベル条件によって異なります。	
追加の信頼性データ:	お客さまの地域のオンセミ営業所または < Tomas.Vajter@onsemi.com > にお問い合わせください。	
通知種別:	これは、お客様宛の最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) です。FPCN は、変更実施の 90 日前に発行されます。 オンセミは、この通知の送付から 30 日以内に書面による問い合わせがない限り、この変更が承諾されたものとみなします。お問い合わせは、< PCN.Support@onsemi.com > 宛てにお願いします。	
変更部品の識別:	製造のトレーサビリティは、製品のデータコードによって管理されます。	
変更カテゴリ:	ウエハファブの変更	
変更サブカテゴリ:	製造プロセスの変更	
影響を受ける拠点:		
オン・セミコンダクター拠点:	外部製造工場 / 下請業者拠点:	
onsemi Wafer Substrate Manufacturing Roznov, Czech Republic	なし	
説明および目的		
<p>本 FPCN は、オンセミ、チェコ共和国 (ロジュノフ) のウエハ製造施設で施設の生産性を向上させるため、小さめのウエハサイズから大きめのウエハサイズへの変更をお知らせするものです。</p> <p>デバイスの機能性に変更はなく、電気仕様範囲内の性能であることを確認するために、各製品について温度範囲全体にわたる全面的な電気特性評価が実施されました。</p> <p>また、移管されたデバイスに変更がないことを確認するために品質試験も実施されました。</p>		
変更前の表記		
<p>小さめのウエハサイズから大きめのウエハサイズに変更することにより、ウエハ製造施設の生産性を高めます。 ウエハサイズ: 150mm 場所: オンセミ、チェコ共和国 (ロジュノフ) のウエハ製造施設</p>		
変更後の表記		
<p>小さめのウエハサイズから大きめのウエハサイズに変更することにより、ウエハ製造施設の生産性を高めます。 ウエハサイズ: 200mm 場所: オンセミ、チェコ共和国 (ロジュノフ) のウエハ製造施設</p>		

信頼性データの要約:

デバイス名: NCV33074

RMS: 69241

パッケージ: SOIC14

テスト	仕様	条件	間隔	結果
HTOL	JA108	Ta= 125°C, Test @ R, H, C	2016 hrs	0/240
PC	JA112	SMD only, Test @ 0 & EP		0/231
	JA113			
SAT		Test pre- and post- PC		pass
ELFR	JA018	TA = 125°C for 48 hrs; Test @ R, H	48hrs	0/2400
TC	JA104	Test @ R, H	1000cyc	0/270
BS	AEC-Q100-001	30 bonds from 5units; after TC500/1000cyc		pass
BPS	M883	3gm Pull Force Min; after TC500/1000cyc		pass
	Method 2011			
ESD HBM	AEC-Q100-002	c = 0, Test @ R, H	2kV	0/3
ESD CDM	AEC-Q100-011	c = 0, Test @ R, H	1kV	0/3
ED	ON Data Sheet	Cpk > 1.67	Cpk>1.67	Pass
		Test @ R, H, C		(3 wafer lots)
LU	AEC-Q100-004	Test @ EP; Test & Stress @ R, H	LU+>100mA	0/6

電気的特性の要約:

電気的特性への影響はありません。すべてのデータシートの仕様は同じです。

影響を受ける部品の一覧:

注: 部品一覧には標準部品番号 (既製品) のみが記載されています。本 PCN の影響を受けるカスタム部品番号は、PCN メールで提供される顧客個別の付録、または PCN カスタマイズポータルに記載されています。

部品番号	認定試験用ピークル
SC2902DTBR2G	MC33074ADR2G
LM324ADTBR2G	MC33074ADR2G
LM324ADR2G	MC33074ADR2G
MC34074DR2G	MC33074ADR2G
MC34074ADR2G	MC33074ADR2G
MC33074DTBR2G	MC33074ADR2G
MC33074ADTBR2G	MC33074ADR2G
MC33074ADR2G	MC33074ADR2G